公司代码:688200　　公司简称:华峰测控

北京华峰测控技术股份有限公司

2019 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　重大风险提示

无

3　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第十七次会议审议,公司2019年度利润分配方案拟定如下:以本次权益分派股权登记日总股本61,185,186股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币6元(含税),共计分配现金股利人民币36,711,111.6元(含税),不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

7　是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华峰测控	688200	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	孙倏	魏文渊
办公地址	北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层	北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层
电话	010-63725652	010-63725652
电子信箱	ir@accotest.com	ir@accotest.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)　主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于专用设备制造业(行业代码:C35);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),公司属于专用设备制造业中的电子和电工机械专业设备制造下的半导体器件专用设备制造(行业代码:C3562)。公司所在行业属于科创板重点推荐的“新一代信息技术”领域中的“半导体和集成电路”。

按照产品主要用于模拟及混合信号类集成电路的测试,产品销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国等全球半导体产业发达的国家和地区。自成立以来,公司始终专注于半导体自动化测试系统领域,以其自主研发的产品实现了模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代。目前,公司已成长为国内最大的半导体测试系统本土供应商,也是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商。

公司在二十余年的发展历程中多次突破了国外巨头的技术垄断,创造了我国行业内里程碑式的技术突破:公司旗下STS 8200 产品是国内率先正式投入量产的全浮动测试的模拟测试系统,STS 8202 产品是国内率先正式投入量产的 32 工位全浮动的 MOSFET 晶圆测试系统,STS 8203 产品是国内率先正式投入量产的板卡架构交直流同测的分立器件测试系统,并且可以自动实现交直流数据的同步整合。此外,公司于 2014 年推出了“CROSS”技术平台,在该技术平台上通过更换不同的测试模块实现模拟、混合、分立器件、MOSFET 等多类别器件测试;公司于 2018 年推出了可将所有测试模块装在测试头中的 STS 8300 平台,该平台具备 64 工位以上的并行测试能力,能够测试更高引脚数和更多工位的模拟及混合信号类集成电路。

(二)　主要经营模式

1、盈利模式

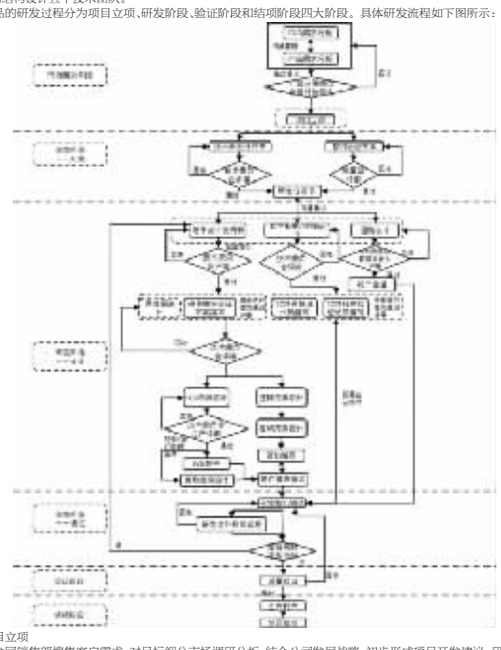
公司专业从事半导体自动化测试系统的研发、生产和销售,向集成电路设计、晶圆制造、封装测试等领域客户提供优质高效的半导体自动化测试系统及配件,并获取收入和利润。报告期内,公司主营业务收入来源于半导体自动化测试系统和测试系统配件的销售。

2、研发模式

公司主要采用自主研发模式,拥有多项核心技术的自主知识产权。

公司建立了以基础实验室和研发部为核心的研发组织体系,基础实验室负责前沿技术追踪和研究,研发部负责从基础技术、产品技术和应用技术三个层次开展具体研发工作。为提高研发效率,研发部分为软件设计、硬件设计、PCB设计、FPGA设计和结构设计五个技术团队。

公司产品的研发过程分为项目立项、研发阶段、验证阶段和结项阶段四大阶段。具体研发流程如下图所示:



(1)项目立项

市场部会同销售部搜集客户需求,对目标细分市场调研分析,结合公司发展战略,初步形成项目开发建议。研发部和财务部对项目进行可行性分析,汇总形成《市场需求分析说明书》、《产品需求分析说明书》和《可行性报告》后提交产品决策委员会,由产品决策委员会讨论研发项目的可行性。审核通过后,项目正式立项并进入研发阶段。

(2)研发阶段

1)方案环节:项目负责人制定详细的性能参数和技术规格,向技术委员会提交《技术开发任务书》,同时向质量部提交《整机验证方案》,审核确认后形成《研发任务书》,进入设计环节;

2)设计环节:项目负责人将任务下发到硬件、软件等团队进行研发设计,技术委员会在研发关键节点对阶段性研发成果进行审核评估,确认项目完成度及相关性能参数、技术规格符合《研发任务书》要求;

3)调试环节:进行研发样机调试,并提供样机试用,样机试用通过后定型。

(3)验证阶段

对产品的功能、精度、稳定性等方面进行验证测试,主要包括研发部验证、质量部验证以及客户端验证三个环节,验证测试通过后进行量产和结项。

(4)结项阶段

研发部联合质量部和生产部撰写产品配套文档,并提交《项目总结报告》,对项目相关资料和研发过程进行整理归类。

3、采购模式

公司的对外采购主要为原材料的采购,公司采购的原材料主要包括元器件、连接件、电缆、PCB、结构件、电源和工控机等。

(1)具体采购模式

1)公司的绝大多数原材料直接向原厂采购;

2)部分进口的原材料供应商在国内无直销渠道,只通过原厂指定的分销商在国内市场销售,因此公司向原厂指定的代理商及其分销商采购。

(2)具体采购流程

1)价格协定:公司与原厂或原厂指定的代理商及其分销商联系,向原厂申请原材料的协议价格;

2)提供需求:公司销售部门每月根据销售半年度计划、在手订单情况及市场需求预测编制销售计划,生产部会同采购部根据销售计划编制当月采购计划。根据上述采购计划,公司提供原材料的需求预测给原厂或原厂指定代理商及其分销商,通过代理商将需求递至原厂;

3)收到原料:公司收到物料后验收入库。

(3)采购定价方式

公司采购定价方式主要为“询价+比价”。除加急采购、定点采购外,同一种物料需3家以上合格供应商同时询价;定点采购方面,公司与供应商协商定价。

(4)供应商管理方式

1)背景调查:采购部对供应商基本情况、经营能力、合法合规等方面进行背景调查;

2)供应商选择:质量部同研发部、生产部、采购部根据《合格供方选择和评价规则》,结合采购项目技术标准和要求,通过同类项目不同供方所提交的相关资料,综合质量、价格、服务信息进行比较,初步选定候选供方的名单;

3)供应商评价:公司每年对合格供应商名录上的供应商进行综合评分,取消总评分或质量评分低的供应商合格供方资格。

目前,公司已与多个优秀供应商建立了长期稳定的合作关系,可在最大程度上保障原材料采购的稳定。

4、生产模式

按照产品特点及市场销售规律,公司采用“销售预测+订单”安排生产计划,并根据核心工序自主生产、成熟工序委托外协的方式组织生产,完成生产计划。

(1)销售预测+订单

销售部每季度初进行销售预测,生产部结合已有订单并平衡库存,提交季度投产计划,经批准后下达采购需求,安排生产任务。

(2)自主生产+外协生产

生产过程中的单板组装调试、整机调试等核心工序及模块成组等环节由公司自主独立完成,公司从合作供应商处定制机柜结构件、PCB板等原材料,将电路板焊接工序委托外协厂商完成。

外协生产模式下,公司向外协厂商提供元器件等原材料,外协厂商按照公司的产品规格、图纸、质量标准和工艺流程文件进行生产。市场上可供选择的同类型外协厂商较多,公司不存在依赖单一外协厂商的情形。

公司采取多种措施控制外协质量:1)公司与外协厂商签订委托加工协议,外协厂商须按照公司提供的产品规格、图纸、质量标准和工艺流程文件进行生产,协议同时约定了产品验收标准、争议解决机制等;2)每件外协产品入库前均须通过质量部检验,不符合质量要求的外协产品按约定方式处置;3)质量部每月召开内部例会,对质量问题进行处理,对于多发性问题责成外协厂商整改,整改不力的外协厂商将被剔除出合格供应商名录。

公司采取了严格的外协加工保密措施。委托加工协议约定外协厂商不得泄露和透露公司的任何商业信息和技术信息等资料,否则将承担赔偿责任。报告期内,未发生外协厂商泄露和透露公司商业信息和技术信息等资料的情况。

5、销售模式

根据下游市场需求和自身产品特点,公司采取“直销为主,经销为辅”的销售模式。直销客户包括境内外集成电路设计、晶圆制造和封装测试厂商,经销客户为境外贸易商。通过该销售模式,公司与境内外下游客户保持了密切联系,深入了解需求,不断完善产品和服务,增加市场份额和品牌知名度。

直销模式下,公司主要通过商业谈判、招投标的方式获取订单。公司按照华东、西北、华南和海外等地区进行区域化营销管理,并在苏州、西安、成都等地设置了服务中心。市场部负责了解技术发展方向、市场供需情况及竞争对手状况,销售部负责客户需求信息收集分析、产品推广、商务谈判、合同签订及客户维护,服务部负责产品的安装、验收、维修维护和技术支持。

公司通过参加行业展会、研讨会和广告等方式提高品牌知名度,展示公司技术实力,扩大客户群体。针对潜在客户,销售人员通过客户推荐、主动拜访等方式搜集客户需求信息,并通过电话沟通、定期拜访等方式向客户展示技术优势及推介产品;针对老客户,公司通过售后服务和定期回访了解客户产品使用情况,并借助长期合作关系开发新需求。需求确认后,公司与客户进行技术沟通、开展方案沟通、样品测试、数据评估等工作,确定产品配置,商定销售价格,促成销售。安装与验收后,公司向客户持续提供技术支持、维修维护和跟踪改善等服务。

经销模式下,公司销售对象为境外贸易商,该等客户在半导体测试行业领域积累了较多的境外客户资源,拥有较为成熟的境外销售渠道,同时自身的技术水平和团队也能够为终端客户提供一定的技术支持服务。境外贸易商会了解下游终端客户的提货需求,并定期与公司沟通未来一段时间内的订货安排,向公司下达订单。公司向经销商的销售为买断式销售,在公司将商品销售给经销客户后,商品的所有权转移至经销客户,公司根据订单约定将货物交付经销商指定地点后即实现风险与报酬的转移,公司不存在经销分级的情形,不存在对经销商的财务、资金资助、返利等优惠政策。

(三)　所处行业情况

1.　行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司报告期内主要产品为半导体自动化测试系统及测试系统配件,属于半导体测试设备行业中的半导体测试机子行业。

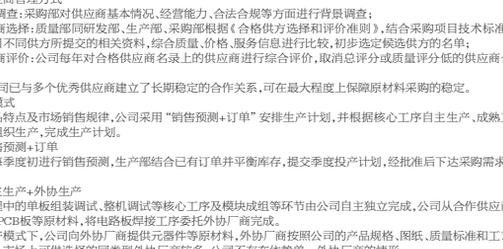
在测试设备中,测试机用于检测芯片功能和性能,技术壁垒高,尤其是客户对于集成电路测试在测试功能模块、测试精度、响应速度、应用程序定制化、平台可延展性以及测试数据的存储、采集和分析等方面提出愈来愈高的要求。探针台与分选机实现被测晶圆/芯片与测试机功能模块的连接。

晶圆检测环节需要使用测试机和探针台,成品测试环节需要使用测试机和分选机,具体测试流程如下:

晶圆检测环节:晶圆检测是指在晶圆完成后进行封装前,通过探针台和测试机的配合使用,对晶圆上的裸芯片进行功能和电参数测试。探针台将晶圆逐片自动传送至测试位置,芯片的Pad点通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接,测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号,判断芯片功能和性能在不同工作条件下是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给探针台,探针台据此对芯片进行打点标记,形成晶圆的Map图。该环节的目的是确保在芯片封装前,尽可能地把无效芯片筛选出来以节约封装费用。

成品测试环节:成品测试是指芯片完成封装后,通过分选机和测试机的配合使用,对封装完成后的芯片进行功能和电参数测试。分选机将被测芯片逐个自动传送至测试工位,被测芯片的引脚通过测试工位上的基座、专用连接线与测试机的功能模块进行连接,测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号,判断芯片功能和性能在不同工作条件下是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给分选机,分选机据此对被测芯片进行标记、分选、收料或编带。该环节的目的是保证出厂的每颗集成电路的功能和性能指标能够达到设计规范要求。

集成电路生产及测试具体流程:



随着2018-2020年中国大陆多家晶圆厂陆续投建及量产,国内封测厂陆续投入新产线以实现产能的配套扩张,将持续带动国内半导体测试设备市场高速增长。

(2)半导体测试机行业概况和竞争格局

半导体测试机又称半导体自动化测试机,与半导体自动化测试系统同义。两者由于翻译的原因,以往将Tester翻译为测试机,诸多行业报告沿用这个说法,但现在越来越多的企业将该等产品称之为ATE system,测试系统的说法开始流行,整体上无论是被称为Tester还是ATE system,皆为软硬件一体。

半导体测试机测试半导体器件的电路功能、电性能参数,具体涵盖直流参数(电压、电流)、交流参数(时间、占空比、总谐波失真、频率等)、功能测试等。

集成电路测试贯穿了集成电路设计、生产过程的核心环节,具体如下:

第一、集成电路的设计流程需要芯片验证,因对晶圆样品和集成电路封装样品进行有效性验证;

第二、生产流程包括晶圆制造和封装测试,在这两个环节中可能由于设计不完善、制造工艺偏差、晶圆质量、环境污染等因素,造成集成电路功能失效、性能降低等缺陷,因此,分别需要完成晶圆检测(CP, Circuit Probing)和成品测试(FT, Final Test),通过分析测试数据,能够确定具体失效原因,并改进设计及生产、封测工艺,以提高良率及产品质量。无论哪个环节,要测试芯片的各项功能指标均须完成两个步骤:一是将芯片的引脚与测试机的功能模块连接起来,二是通过测试机对芯片施加输入信号,并检测输出信号,判断芯片功能和性能是否达到设计要求。

集成电路测试原理:

随着集成电路技术不断发展,芯片线宽尺寸不断减小,制造工序逐渐复杂,对集成电路测试设备要求愈加提高,集成电路测试设备的制造需要综合运用计算机、自动化、通信、电子和微电子等学科技术,具有技术含量高、设备价值高等特点。

(3)半导体测试机行业的技术壁垒(技术门槛)

半导体测试系统涵盖多门学科的技术,包括计算机、自动化、通信、电子和微电子等,为典型的技术密集、知识密集的高科技行业,用户对测试系统的可靠性、稳定性和一致性要求较高,半导体测试系统的技术壁垒也比较高。具体技术壁垒如下:

1)并行测试数量和测试速度的要求不断提升。在相同的测试时间内,并行测试芯片越多,测试效率越高,平均的测试成本越低。并行测试数越多,对测试系统的功能、密度及不同测试工位的一致性及稳定性要求就越高。

2)对测试机的功能模块需求增加。由于越来越多的模拟、数字、高精度、高性能甚至更高功率的功能通过先进的芯片设计和加工工艺或封装工艺集成在一块芯片或模块上,对于测试机内的功能模块的能力要求也越来越高。

3)对测试精度的要求提升。客户对测试机各方面的精度要求在提升,如:测试电压精确到微伏(μV)、测试电流精确到皮安(pA)、测试时间精确到百皮秒(100pS),从测试系统的设计来看,每个元器件的选择、电路板的布局到系统平台结构的设计都会影响到测试机的测试精度和可靠性。

4)要求使用通用化软件开发平台。随着集成电路产品门类的增加,要求测试设备具备通用化软件开发平台,方便客户进行二次应用程序开发,以适应不同产品的测试需求。

5)对数据分析能力提升。下游客户要求测试设备对芯片的状态、参数监控、生产质量等数据进行大数据分析,因此对测试机的数据存储、采集和处理能力要求提升。

半导体测试系统企业需要经过多年的技术和市场的经验积累储备大量的修正数据,以确保上述性能指标达标与持续优化,并确保测试设备长期稳定运行。行业内的新进入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累,才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡,很难在短期内全面掌握所涉及的技术,因此本行业具有较高的技术壁垒。

2　公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为国内最早进入半导体测试机行业的企业之一,公司在行业内深耕二十余年,目前是国内最大的半导体测试系统本土供应商。

凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点,公司已在模拟及数模混合测试机领域打破了国外厂商的垄断地位,在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平,目前为国内前三大半导体封测厂商模拟测试领域的主力测试平台供应商,并进入了国际封测市场供应商体系,实现了进口替代。

从早期自主研发的STS 2000系列测试系统开始,公司各系列产品广泛应用于航天、航空、电子、核工业、船舶、铁路等关键领域。公司于2003年进入集成电路测试机领域,聚焦于模拟和混合信号测试机领域,依托自主研发,不断加大研发投入,成功开发出STS 8200系列测试机产品,打破国外垄断。凭借技术优势和稳定性能,STS 8200系列产品装机量实现快速增长,产品不但在中国境内批量销售,还外销至中国台湾、美国、欧洲、韩国、日本等境外半导体产业发达地区,截至报告期末,全球累计装机量突破2,600台。

公司STS 8200系列产品是国内率先实现规模量产的浮动源测试系统,具有高精度、高灵活性的显著技术特征,解决了具有公共端晶圆多工位并测的难题,极大地提高了测试准确性,降低了测试成本。该产品获得了国家科技重大专项极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项实施管理办公室颁发的“2011年度突出成果奖”和中国半导体行业协会颁发的第五届“中国半导体创新产品和技术奖”。

2014年,公司推出了“CROSS”技术平台,可在同一个测试技术平台上通过更换不同的测试模块实现了模拟及混合集成电路、分立器件、MOSFET等多类别的测试,提高了平台延展性,避免了客户的重复投资,便利了客户测试工程师的持续使用,节省了客户的维护费用,从而增强了客户使用公司产品的粘性。

2018年,公司成功开发出下一代的STS 8300平台,特色是“ALL in ONE”,因将所有测试模块装在测试头中,具备64工位以上的并行测试能力,能够测试更高引脚数、更多工位的模拟及混合信号集成电路,是公司未来重点发展的技术平台,目前已获得中国大陆、中国台湾和美国客户的订单。

3　报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)报告期内,集成电路产业模式由IDM向精细化分工转化。

集成电路行业的经营模式主要包括IDM模式和Fabless模式两类。IDM模式指垂直整合模式,该模式下企业能够独自完成集成电路设计、晶圆制造、封装测试的所有环节,为集成电路行业发展较早期最为常见的模式,但由于IDM模式对企业的研发力量、生产管理能力、资金实力和业务规模均有很高的要求,因此目前只为少数大型企业所采纳。Fabless模式指无晶圆厂模式,该模式下企业主要从事芯片的设计和销售,而将晶圆制造、封装测试环节通过委外方式进行,不必投资大量资金建设晶圆生产线、封测工厂等,目前为全球绝大多数集成电路企业所采用。

(2)未来发展趋势

根据CSIA数据,2018年国内集成电路市场规模为985亿美元,同比增长18.53%,2010年至

2018年国内集成电路市场复合增长率达到21.10%,高于全球市场同期年复合增长率,中国已经成为全球最大的集成电路市场。随着产业结构的调整,中国集成电路的需求将持续增长。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	493,584,129.96	286,081,428.35	72.53	209,254,059.69
营业收入	254,610,663.45	218,676,733.27	16.43	148,573,034.68
归属于上市公司股东的净利润	101,987,135.51	90,729,261.19	12.41	52,811,448.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,588,319.97	90,549,290.64	12.19	52,391,517.58
归属于上市公司股东的净资产	428,011,297.27	235,655,270.50	81.63	177,226,009.31
经营活动产生的现金流量净额	59,650,879.90	101,779,194.12	-41.39	10,634,700.70
基本每股收益(元/股)	2.27	2.16	5.09	1.26
稀释每股收益(元/股)	2.27	2.16	5.09	1.26
加权平均净资产收益率(%)	28.65	42.06	减少13.41个百分点	34.33
研发投入占营业收入的比例(%)	12.83	11.15	增加1.68个百分点	12.04

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	59,780,523.92	42,465,079.80	98,921,261.95	53,443,797.78
归属于上市公司股东的净利润	23,235,299.56	14,748,551.37	43,387,048.26	20,616,236.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,583,064.15	15,312,825.47	43,085,837.73	20,606,592.62
经营活动产生的现金流量净额	14,263,595.16	5,015,131.49	-9,184,318.67	49,556,471.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	16
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,986
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况

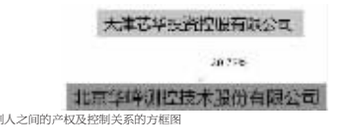
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
天津芯华投资控股有限公司	0	18,229,556	39.73	18,229,556	0	无	0	境内非国有法人
中国时代远望科技有限公司	0	14,134,316	30.80	14,134,316	0	无	0	国有法人
深圳芯瑞创业投资合伙企业	3,888,889	3,888,889	8.47	3,888,889	0	无	0	境内非国有法人
李寅	0	2,200,284	4.79	2,200,284	0	无	0	境内自然人
王皓	0	2,053,323	4.47	2,053,323	0	无	0	境内自然人
唐桂琴	0	1,334,453	2.91	1,334,453	0	无	0	境内自然人
陈爱华	0	1,025,833	2.24	1,025,833	0	无	0	境内自然人
王东光	0	512,917	1.12	512,917	0	无	0	境内自然人
段宁远	0	439,643	0.96	439,643	0	无	0	境内自然人
付卫东	0	439,643	0.96	439,643	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

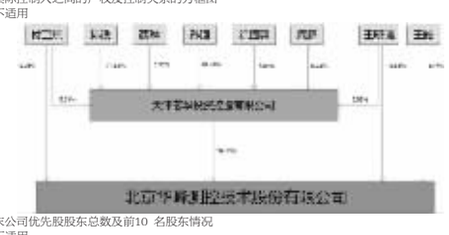
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入254,610,663.45元,比2018年同期增长16.43%;归属于上市公司股东的净利润101,987,135.51 元,比2018年同期增长12.41%。

2　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:	/	/	/
应收账款	35,570,533.82	-414,102.85	35,156,430.97
其他应收款	542,762.95	19,386.70	562,149.65
递延所得税资产	983,336.49	57,907.41	1,041,243.90
股东权益:	/	/	/
未分配利润	118,028,778.81	-336,808.74	117,691,970.07
母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:	/	/	/
应收账款	35,040,722.37	-414,102.85	34,626,619.52
其他应收款	774,325.99	6,386.70	780,712.69
递延所得税资产	719,069.83	61,157.41	780,227.24
股东权益:	/	/	/
未分配利润	107,287,545.50	-346,558.74	106,940,986.76

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

4　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司2019年度将北京盛态思软件有限公司、华峰测控技术(天津)有限责任公司、爱格测试技术有限公司纳入合并财务报表范围。

证券代码:688200　　证券简称:华峰测控　　公告编号:2020-023

北京华峰测控技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排,公司鼓励股东(或股东代理 人)采用网络投票方式参加本次股东大会。股东(或股东代理人)如确 需到现场参会,请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健 康状况申报、隔离、观察等规定和要求。股东(或股东代理人)请服从 工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求,请全程 佩戴口罩,并保持必要的座次距离。敬请配合,谢谢。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月15日 14点00分

召开地点:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权,内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华峰测控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2019年度财务决算的议案	√
3	关于公司2020年度财务预算的议案	√
4	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案	√
8	关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
10	关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>及议事规则?并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案?相关手续的议案?	√
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
12	关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案	√
13	关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案	√
14	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
15	关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	√
16	关于核实公司<2020?年限制性股票激励计划激励对象名单的议案	√
17	关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	√
18	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2.特别决议议案:10、15、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案:7、9、10、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:付卫东、王晓强、天津芯华投资控股有限公司和中国时代远望科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688200	华峰测控	2020/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2020年5月12日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。?

(二)登记地点

北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2020年 5 月 12日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股 东大会”字样。

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记,信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,请于 2020 年 5 月 12 日下午 17 时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并请来电确认登记状态。

6、注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东 账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层董事会办公室

邮政编码:100071

联系电话:010-63725652

电子邮箱:ir@accotest.com

联系人:王皓

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京华峰测控技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2019年度财务决算的议案